



Le mot du Président,

« Le meilleur forum EMPC depuis des années », c'est ainsi que beaucoup de visiteurs ont qualifié l'excellente organisation et la fréquentation élevée de cette conférence-salon « European Microelectronics Packaging Conference » que notre association a organisée à Grenoble en septembre. Cette manifestation reste la plus importante pour notre industrie du packaging des semi-conducteurs en Europe, et je tiens à remercier ceux d'entre vous qui ont contribué à en faire un succès, par votre présence à l'évènement ou votre active collaboration.

Ce succès laisse aujourd'hui notre association dans une situation financière confortable que nous n'avons plus connue depuis des années. Nous avons donc les moyens d'entreprendre des actions qui contribueront à accroître et à faire rayonner notre savoir-faire si rare aujourd'hui en Europe, et donc si précieux. C'est donc un message que je lance à tous nos adhérents : dévoilez-vous et vos idées, invitez-vous dans le débat, soyez force de proposition, afin que notre action bénévole continue à faire vivre nos métiers en France et en Europe par l'échange et la diffusion d'idées.

Votre implication peut prendre différentes formes. L'une d'entre elles consiste à vous présenter aux élections du comité directeur qui auront lieu au printemps prochain. Pour ma part, j'ai décidé de passer le relais de la présidence lors du prochain comité directeur, celui qui se réunira juste après les prochaines élections, en juin prochain. Il est temps que de nouvelles énergies s'expriment, afin que notre motivation de groupe s'épanouisse. Alors que nous venons de prouver qu'on pouvait encore organiser des conférences de qualité réunissant de nombreuses personnes en Europe et en France, le plus grand danger concernant notre association serait qu'elle s'immobilise. Je vous en prie donc, sortez du bois !

Jean-Marc Yannou

Calendrier IMAPS France 2013-2014

9-12 septembre 2013, Grenoble EMPC 2013
7-8 novembre 2013, Tours Journée Puissance
5-6 Février 2014, La Rochelle 9 ^e ATW Européen Micropackaging et Management Thermique
20-21-22 mai 2014, Grenoble 3 ^e MiNaPAD
5 Juin 2014 Paris Comité Directeur et Assemblée Générale
Octobre 2014, Tours ATW Puissance
10-11 décembre 2014, Lyon 2 ^e ATW Européen Micropackaging pour Electronique Médicale

EMPC 2013

Douze ans après Strasbourg, IMAPS France avait à nouveau le plaisir d'accueillir, cette année, l'«*European Microelectronics and Packaging Conference* » (EMPC).

Organisée conjointement par IMAPS Europe et IEEE-CPMT (Components, Packaging and Manufacturing Technology) et en partenariat avec le CEA/LETI, la plus importante manifestation européenne dans son domaine, se tenait à **L'EUROPOLE de Grenoble, du 9 au 12 septembre 2013.**

S'inscrivant dans le prolongement des réussites de nos forums MiNaPAD de 2011 et 2012, l'EMPC 2013 a rencontré un succès amplifié par sa dimension internationale, en réunissant plus de 300 professionnels européens et mondiaux.



Un programme technique de très haut niveau réunissait, du 10 au 12 septembre, 102 présentations orales en 24 sessions et 14 présentations commentées sur posters. Deux cent vingt-huit auditeurs y ont assisté.

Réparties sur les trois journées, trois conférences invitées (keynotes) mettaient l'accent sur les conséquences de la miniaturisation, croissante, de systèmes de plus en plus complexes : l'intégration ne s'arrête pas au silicium mais doit prendre en compte des éléments hétérogènes comme les composants passifs, des « interposeurs » de connectique, des interfaces thermiques.

La meilleure présentation et le meilleur poster ont été récompensés par un prix.

Tobias Bandi, étudiant en doctorat de physique au CSEM-Neuchâtel, prix du meilleur papier (Analysis of Stress in Silicon-based Microsystems by Xray Diffraction), a reçu un iPad offert par IMAPS France.



Le prix poster (500€ par IEEE/CPMT) a été attribué à **Hyun-Cheol Bae**, Senior Researcher / Ph. D. à Electronics and Telecommunications Research Institute de Daejeon, en Corée, qui présentait un procédé original d'assemblage intitulé « Solder on Pad for Fine Pitch Copper Pillar Bumps ».

Le programme est accessible sur le site www.empc2013.com qui restera ouvert jusqu'en

juillet 2014. Ce programme était précédé, le 9 septembre, par quatre cours tutoriels :

SC1 : Probabilistic Design for Reliability (PDR) in Electronics, Opto-electronics and Photonics – Ephraim Suhir, USA

SC2: Design for Reliability for Lead-Free - Petri Savolainen, Finland

SC3 : An Introduction to advanced semiconductor packaging - Jean-Marc Yannou, France

SC4 : Thermal Management - Jean-Luc Diot, France

Egalement le lundi 9 septembre le consortium INEMI (International Electronics Manufacturing Initiative) organisait un workshop prospectif dédié aux futurs défis technologiques de l'électronique automobile.



Par ailleurs l'exposition, complément indispensable des conférences, a également rencontré un franc succès. Elle reste le lieu privilégié de communication et d'échanges techniques et commerciaux entre les exposants, les auditeurs et les conférenciers. Les exposants l'ont bien compris, les soixante stands disponibles ayant été retenus dès la fin du mois de mai. Enfin n'oublions pas son rôle de contributeur à la réussite économique d'un tel événement.

Au total 450 personnes ont participé à ce 19^e EMPC avec une forte contribution internationale puisque 22 pays étaient représentés.

IMAPS France remercie les sponsors dont le soutien a contribué à la qualité de l'accueil :

- Les entreprises ASE (Advanced Semiconductor Engineering), Heraeus, STMicroelectronics et Sencio,
- Le consortium INEMI (International Electronics Manufacturing Initiative),
- l'Agence d'Etudes et Promotion de l'Isère.

YOLE Développement, conseil en Marketing et Technologie, a pour sa part contribué à la promotion de l'événement. Il nous reste à féliciter ceux qui ont plus particulièrement contribué au succès :

Brigitte Braux qui a assumé la présidence de l'événement, Gilles Poupon pour le management technique et l'équipe Interconex pour la logistique.



ATW PUISSANCE 2013

Pour la première fois IMAPS France souhaitait élargir l'audience de la « Journée » au niveau européen. L'ATW organisé les **7 et 8 novembre 2013** avec le Laboratoire de Microélectronique de Puissance de Tours et avec le soutien de **ST Microelectronics** a réuni 50 participants.



L'ouverture internationale a permis d'accueillir, à côté de sept présentations françaises, quatre autres de trois pays différents.

Introduite par une conférence invitée la journée du 7 novembre comportait 11 présentations réparties en trois sessions.

En introduction, Régis Hamelin, «Senior Technical Manager» du programme Euripides, présentait une revue prospective intitulée «From Nano to Macro Power Electronics, a European perspective».

Des composants aux sources d'énergie en passant par les technologies et matériaux d'assemblage le programme offrait un regard diversifié sur l'état de l'art et les perspectives d'évolution en électronique de puissance.

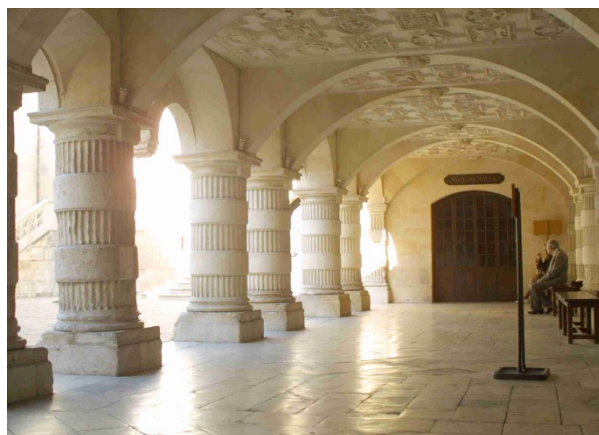


Par ailleurs l'exposition sur table a permis à sept exposants de présenter leurs produits et prestations.

La journée se terminait par une soirée conviviale avec une visite, optionnelle, de site viticole suivie d'un dîner. Enfin la matinée du 8 novembre était consacrée à la visite, optionnelle, des laboratoires Greman/Cetem.

IMAPS France organisera, à TOURS avec les mêmes partenaires, un nouvel ATW dédié à la puissance en 2014, au mois d'octobre, pour éviter un télescopage de dates avec de grands événements comme par exemple Electronica.

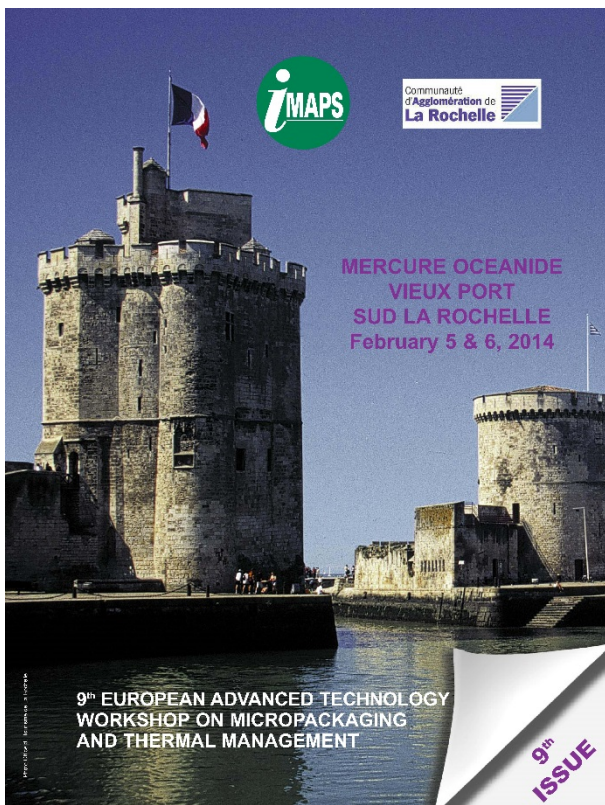
9^e ATW Micropackaging et Management Thermique



CréditPhoto F. Giraudon pour Office de Tourisme La Rochelle

Votre neuvième rendez-vous annuel du management thermique, se tiendra à **La Rochelle les 5 et 6 février 2014**. Le programme vient d'être diffusé. Il réunira 22 présentations (dont 2 posters) consacrées aux diverses solutions de refroidissement par air, par liquide ou changement de phase, aux matériaux et aux méthodes de caractérisation et test. Deux tiers des intervenants venant de huit pays confirment la notoriété internationale de l'événement.

L'exposition spécialisée est désormais bien établie. Plus de vingt exposants, soit la totalité de la place disponible, ont déjà réservé leur emplacement pour y participer.



MiNa PAD 2014



Après les succès des deux premières éditions en 2011 et 2012, IMAPS France a le plaisir d'organiser le **troisième MiNaPAD**, à **Grenoble du 20 au 22 mai 2014** et, comme les précédents, dans les locaux de **MINATEC**. L'appel à communication sera diffusé le **15 décembre**. Les propositions seront prises en compte jusqu'au **début de février**. L'acceptation en sera notifiée aux auteurs à la fin de février.

L'objectif est de diffuser une édition provisoire du programme le 15 mars et le **programme définitif avant la fin du mois d'avril**.

2^e ATW Micropackaging pour Electronique Médicale

La réussite de la première expérience, la satisfaction exprimée par les participants et les perspectives de croissance des marchés de la microélectronique

médicale conduisent IMAPS France à organiser un deuxième ATW sur le même thème en 2014. Cette année il aurait été difficilement compatible avec l'organisation du congrès européen EMPC en septembre. **Ce deuxième ATW se tiendra à Lyon du 9 au 11 décembre 2014, avec une exposition sur table ciblée sur le médical.**

Autres événements 2014-2015

ESTC 2014

Organisée par **IEEE/CPMT**, la cinquième «European System-integration Technologies Conference», se tiendra **du 16 au 18 septembre 2014 au Finlandia Hall d'Helsinki, Finlande.**

EMPC 2015

IMAPS France et IMAPS Europe souhaitent pleine réussite au Chapitre **IMAPS Deutschland**, à qui reviendra l'honneur d'accueillir la **20^e EMPC**, à **Friedrichshafen, du 13 au 16 septembre 2015.**



Informations :

Pour toute information, inscription ou adhésion, contacter

Florence Vireton

imaps.france@imapsfrance.org

01 39 67 17 73

N'oubliez pas de visiter notre site Internet :

www.france.imapseurope.org

IMAPS France vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année